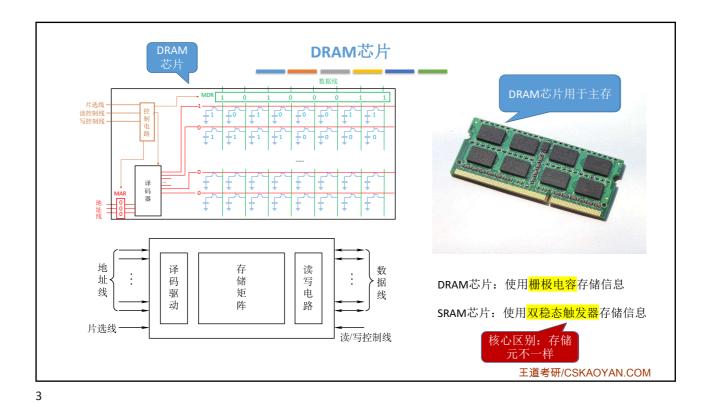
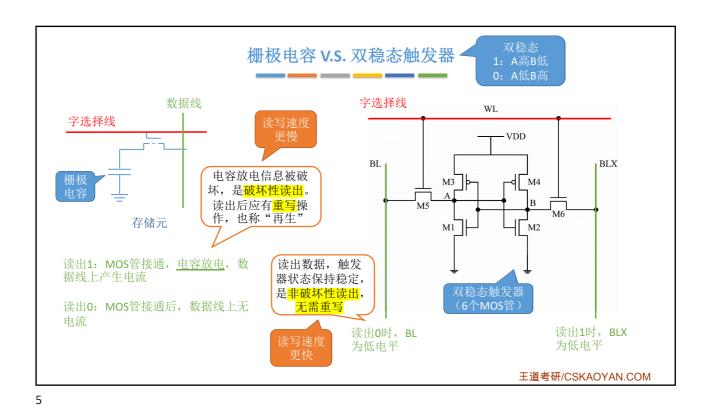


存储元件不同导致的特性差异
DRAM 和 SRAM
DRAM 的刷新
DRAM 的地址线复用技术

Dynamic Random Access Memory,即动态RAM
Static Random Access Memory,即静态RAM
DRAM用于主存、SRAM用于Cache
高頻考点: DRAM和SRAM的对比

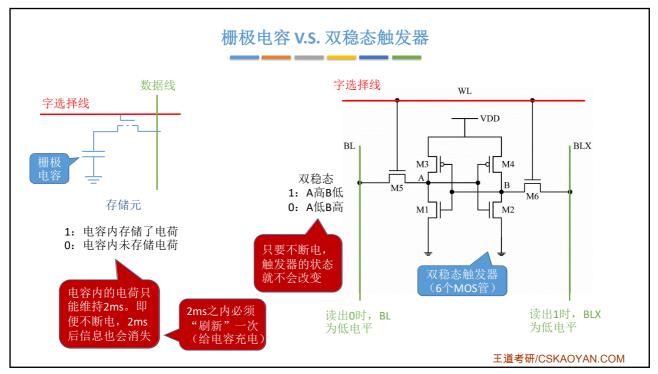
<u>王道考研/CSKAOYAN.COM</u>

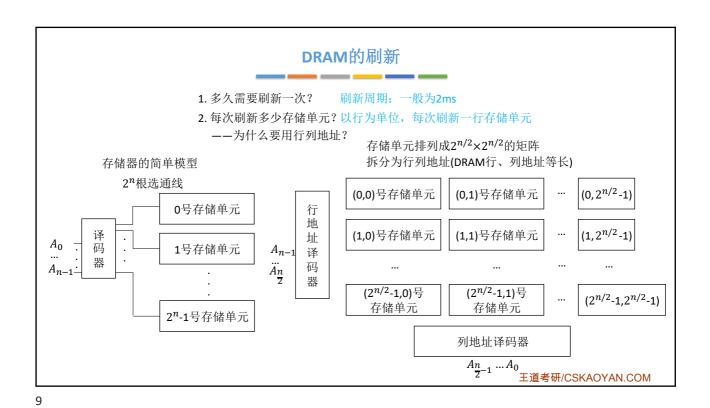


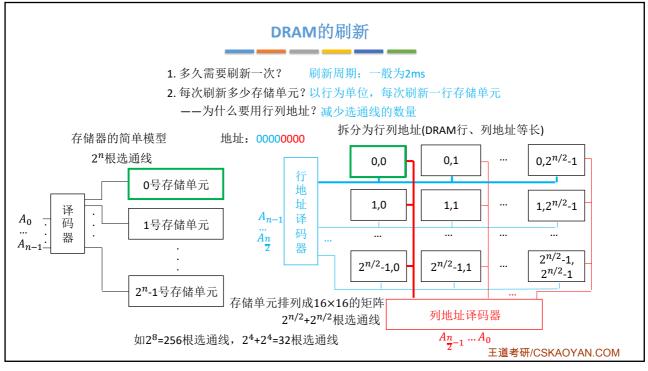


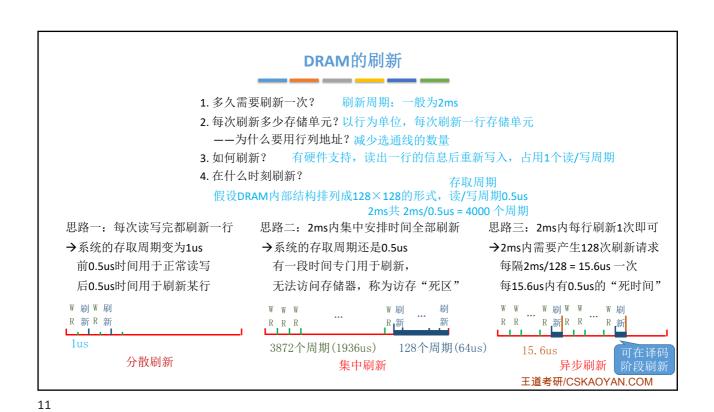
栅极电容 V.S. 双稳态触发器 数据线 字选择线 WL 字选择线 - VDD BL BLX М3 M4 存储元 M1 M2 每个存储元制造成 每个存储元制造成 双稳态触发器 (6个MOS管) 本更低,集成度高, 本更高,集成度低, 功耗低 功耗大 读出1时,BLX 读出0时,BL 为低电平 为低电平 王道考研/CSKAOYAN.COM

DRAM v.s SRAM				
	Static Random Access Memory	Dynamic Random Access Memory		
类 型 特 点	SRAM(静态RAM)	DRAM(动态RAM)		
存储信息	触发器	电容		
破坏性读出	非	是		
读出后需要重写? (再生)	不用	需要		
运行速度	快	慢		
集成度	低	高		
发热量	大	小		
存储成本	高	低		
易失/非易失性存储器?	易失(断电后信息消失)	易失 (断电后信息消失)		
需要"刷新"?	不需要	需要		
送行列地址	同时送	分两次送		
	常用作Cache	常用作主存		

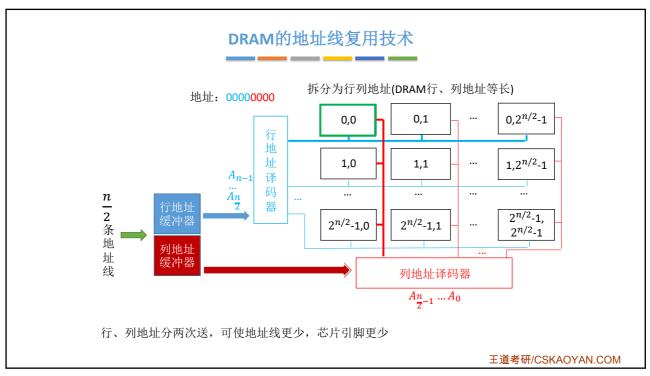








	DRAM v.s SRAM		
	Static Random Access Memory	Dynamic Random Access Memory	
类 型 特 点	SRAM(静态RAM)	DRAM(动态RAM)	
存储信息	触发器	电容	
破坏性读出	非	是	
读出后需要重写? (再生)	不用	需要	
运行速度	快	慢	
集成度	低	高	
发热量	大	小	
存储成本	高	低	
易失/非易失性存储器?	易失(断电后信息消失)	易失(断电后信息消失)	
需要"刷新"?	不需要	需要	
送行列地址	同时送	分两次送	
	常用作Cache	常用作主存	



本节回顾				
	Static Random Access Memory	Dynamic Random Access Memory		
类 型 特 点	SRAM(静态RAM)	DRAM(动态RAM)	现在的主存通 常采用SDRAM 芯片	
存储信息	触发器	电容		
破坏性读出	非	是		
读出后需要重写? (再生)	不用	需要		
运行速度	快	慢		
集成度	低	高		
发热量	大	小		
存储成本	高	低	"刷新"由存	
易失/非易失性存储器?	易失 (断电后信息消失)	易失(断电后信息消失)	储器独立完 成,不需要	
需要"刷新"?	不需要	需要(分散、集中、异步)	CPU控制	
送行列地址	同时送	分两次送(地址线复用技术)	导致地址	
	常用作Cache	常用作主存 王道考研/ C	线、地址 引脚减半 SKAOYAN.COM	